

# 1000 LM SC

激光系列

## 芯片类激光打标设备



Cencorp 1000 LM SC主要用于半导体行业,可以对不同尺寸的芯片进行激光打标。芯片托盘可以快速更换,实现多品种、多批次芯片的灵活生产。

### 灵活性

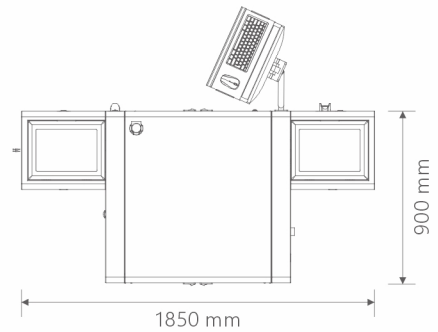
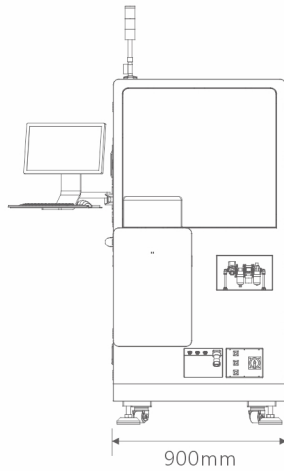
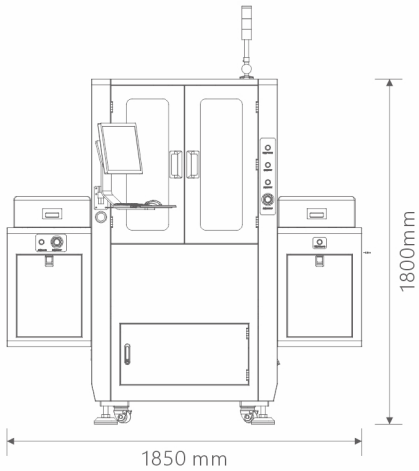
标准配置采用355nm波长紫外激光器,该激光器具有良好的光束质量,光斑直径小,打标效果好,最小可打出0.2x0.2mm的二维码。可根据不同的材料和打标要求选择532nm绿光激光器、光纤激光器或CO<sub>2</sub>激光器,以满足不同客户的个性化需求。

### 高效性

可调整轨道宽度和轨道传送方向  
视觉定位和条码识别  
自动调整激光焦距  
全自动操作

# 1000 LM SC

技术参数



## 设备基本参数

宽度: 1850mm  
深度: 900mm  
高度: 1800mm  
重量: 1000kg

## 运动系统

X轴行程: 450mm  
Y轴行程: 300mm  
Z轴行程: 100mm  
重复定位精度 (X, Y):  $\pm 0.01$  mm  
最大加工尺寸 (W\*L): 135x320mm

## 视觉系统

视觉定位  
视觉检查  
重复定位精度:  $\pm 0.03$ mm

## 激光器参数

激光器类型: 紫外纳秒激光器  
                  光纤激光器 (可选)  
                  绿光激光器 (可选)  
                  CO<sub>2</sub> 激光器 (可选)  
激光波长: 355nm  
平均功率: 3W/5W  
频率: 30-100KHz  
脉冲宽度: <25ns@30KHz

## 激光加工软件

支持条码类型: Code39, EAN,  
                  PDF417, PLT,  
                  DATAMATRIX, QR  
支持文件类型: PLT, DXF, AI, DST,  
                  GBR, NC, BMP, JPG,  
                  JPEG, GIF, PNG, TIF

## 光学系统

扫描范围: 100x100mm@F160  
                  70x70mm@F100 (Optional)  
                  145x145mm@F210 (Optional)  
扫描速度:  $\leq 7000$ mm/s@F160  
最小文本高度: 0.2mm

## 电气要求

电压: AC220V/50Hz  
最大功率: 2.2KW

## 气源要求

气压: 5-7 bar  
预计消耗气量: 100 L/min

## 环境要求

工作温度: 10-40°C  
工作湿度: 30%-85%